



三星电子出 AI 解决方案，骁龙 6s Gen3 提升 AI 性能 ——电子行业周报（2024.06.10-2024.06.14）

核心观点

本周核心观点与重点要闻回顾

玻璃基板：电气硝子推出新型玻璃-陶瓷基板 GC Core，玻璃基板产业或将加速发展。电气硝子此次开发出的 GC Core 基板芯材由玻璃粉末和陶瓷粉末低温共烧而成，拥有陶瓷的部分性质，不易产生裂纹，可直接使用 CO2 激光器钻孔，降低量产成本。我们认为，玻璃基板或将适合 HPC、AI 领域的芯片，相关产业链有望持续受益。

铜连接：GB200 采用铜缆连接，预估 2024 年出货量为 42 万片，相关产业链或将受益。GB200 采用 72 个 Blackwell GPU 全互连的 NVLink 技术，拥有超过 2 英里的 NVLink 铜缆。GB200 在 2024 年预估出货量为 42 万片，2025 年将达到 200 万片。我们认为，GB200 出货顺利或将提振铜连接相关器件需求，相关产业链有望持续受益。

先进封装：三星电子发布三星 AI 解决方案，相关产业链有望持续收益。三星电子发布三星 AI 解决方案。该方案整合了三星内部晶圆代工、存储和先进封装服务，可提供高性能、低功耗和高带宽的 AI 芯片解决方案，能根据客户特定需求定制芯片。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。

算力芯片：骁龙 6s Gen 3 提升 CPU、GPU 和 AI 性能，算力芯片产业链有望持续收益。高通公司证实，骁龙 6s Gen 3 是骁龙 695 的增强版本，主要提升 CPU、GPU 和 AI 性能。我们认为，AI 推动算力需求攀升，相关产业链有望持续受益。

市场行情回顾

本周（6.10-6.14），A 股申万电子指数上涨 4.67%，整体跑赢沪深 300 指数 5.59pct，跑赢创业板综指数 2.99pct。申万电子二级六大子板块涨跌幅由高到低分别为：元件(7.68%)、其他电子 II(7.26%)、消费电子(5.79%)、半导体(4.42%)、电子化学品 II(3.76%)、光学光电子(1.78%)。从海外市场指数表现来看，整体继续维持强势，海内外指数涨跌幅由高到低分别为：费城半导体(5.88%)、道琼斯美国科技(5.48%)、申万电子(4.67%)、台湾电子(4.52%)、纳斯达克(3.24%)、恒生科技(-1.72%)。

投资建议

本周我们继续看好受益算力芯片发展的玻璃基板产业链、受益于英伟达 GB200 的铜连接产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏主线、AI 为核心的算力芯片产业链。

玻璃基板：受益于算力芯片技术发展，产业链有望迎来加速成长，建议关注沃格光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等；

铜连接：受益于英伟达 GB200 出货顺利，产业链需求有望增长，胜蓝股份、创益通、维峰电子、鼎通科技、立讯精密、神宇股份；

先进封装：受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等；

算力芯片：受益于算力需求持续攀升，有望带动上游算力芯片需求增长。建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等。

风险提示

中美贸易摩擦加剧、下游终端需求不及预期、国产替代不及预期等。

增持(维持)

行业： 电子

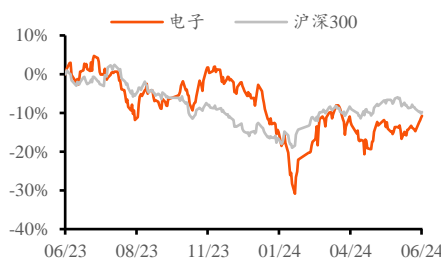
日期： 2024年06月17日

分析师： 陈宇哲

E-mail: chenyzhe@yongxingsc.com

SAC 编号: S1760523050001

近一年行业与沪深 300 比较



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

相关报告：

《Gaudi 3 芯片售价公布，英特尔或重视玻璃基板封装》

——2024 年 06 月 11 日

《康宁推进玻璃基板工艺，台积电称 3D 封装日趋重要》

——2024 年 06 月 03 日

《英伟达 24Q1 业绩亮眼，GB200 或提前导入 FOPLP》

——2024 年 05 月 28 日

正文目录

1. 本周核心观点及投资建议	3
2. 市场回顾	5
2.1. 板块表现	5
2.1. 个股表现	6
3. 行业新闻	8
4. 公司动态	10
5. 公司公告	11
6. 风险提示	12

图目录

图 1: A 股申万一级行业涨跌幅情况 (6.10-6.14)	5
图 2: A 股申万二级行业涨跌幅情况 (6.10-6.14)	5
图 3: A 股申万三级行业涨跌幅情况 (6.10-6.14)	6
图 4: 海内外指数涨跌幅情况 (6.10-6.14)	6

表目录

表 1: 电子行业 (申万) 个股本周涨跌幅前后 10 名 (6.10-6.14)	7
表 2: 电子行业本周重点公告 (6.10-6.14)	11

1. 本周核心观点及投资建议

核心观点：

玻璃基板：电气硝子推出新型玻璃-陶瓷基板 GC Core，玻璃基板产业或将加速发展。据 IT 之家报道，日本电气硝子近日宣布推出新型半导体基板材料 GC Core。相较于有机基板，玻璃基板更为坚固，表面更为光滑，更便于承载超精细电路，是先进封装领域的明星技术。电气硝子此次开发出的 GC Core 基板芯材由玻璃粉末和陶瓷粉末低温共烧而成，拥有陶瓷的部分性质，不易产生裂纹，可直接使用 CO2 激光器钻孔，降低量产成本。我们认为，玻璃基板或将适合 HPC、AI 领域的芯片，相关产业链有望持续受益。

铜连接：GB200 采用铜缆连接，预估 2024 年出货量为 42 万片，相关产业链或将受益。根据财联社报道，黄仁勋介绍，GB200 采用 72 个 Blackwell GPU 全互连的 NVLink 技术，拥有超过 2 英里的 NVLink 铜缆，展现了铜缆连接在高性能计算领域的巨大潜力。英伟达此举是为了减少其数据中心设备的耗电量，使用铜而不是光学器件，可以为每个服务器机架节省 20 千瓦的电力。根据科创板日报报道，从 CoWoS 先进封装产能研判，2024 年下半年估计将有 42 万颗 GB200 送至下游市场，2025 年产出量上看 150 万至 200 万颗。我们认为，GB200 出货顺利或将提振铜连接相关器件需求，相关产业链有望持续受益。

先进封装：三星电子发布三星 AI 解决方案，相关产业链有望持续收益。根据 IT 之家报道，三星电子发布三星 AI 解决方案。该方案整合了三星内部晶圆代工、存储和先进封装服务，是一个“交钥匙”的 AI 芯片制造平台。通过整合各业务部门的独特优势，三星可提供高性能、低功耗和高带宽的 AI 芯片解决方案，能根据客户特定需求定制芯片。三星电子内部的跨部门合作还简化了生产流程中的供应链管理（SCM），缩短了上市时间，使总周转时间显著提高了 20%。目前三星电子可提供处理器与 HBM 内存间 2.5D 封装集成的整体解决方案。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。

算力芯片：骁龙 6s Gen 3 提升 CPU、GPU 和 AI 性能，算力芯片产业链有望持续收益。根据 IT 之家报道，高通公司证实，骁龙 6s Gen 3 芯片并非什么新产品，而是骁龙 695 的增强版本，主要提升 CPU、GPU 和 AI 性能。高通公司于 6 月 7 日发布骁龙 6s Gen 3 处理器，其部件编号为 SM6375-AC，和旧款骁龙 695 芯片（SM6375）几乎相同，并采用相同的 6nm 工艺。这两款芯片组共享相同的 CPU 设置、GPU、调制解调器、相机功能和无线连接套件。高通公司已证实，骁龙 6s Gen 3 是一款“增强型”骁龙 695。我们

认为，AI 推动算力需求攀升，相关产业链有望持续受益。

投资建议：

本周我们继续看好受益算力芯片发展的玻璃基板产业链、受益于英伟达 GB200 的铜连接产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏主线、AI 为核心的算力芯片产业链。

玻璃基板：受益于算力芯片技术发展，产业链有望迎来加速成长，建议关注沃格光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等；

铜连接：受益于英伟达 GB200 出货顺利，产业链需求有望增长，胜蓝股份、创益通、维峰电子、鼎通科技、立讯精密、神宇股份；

先进封装：受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等；

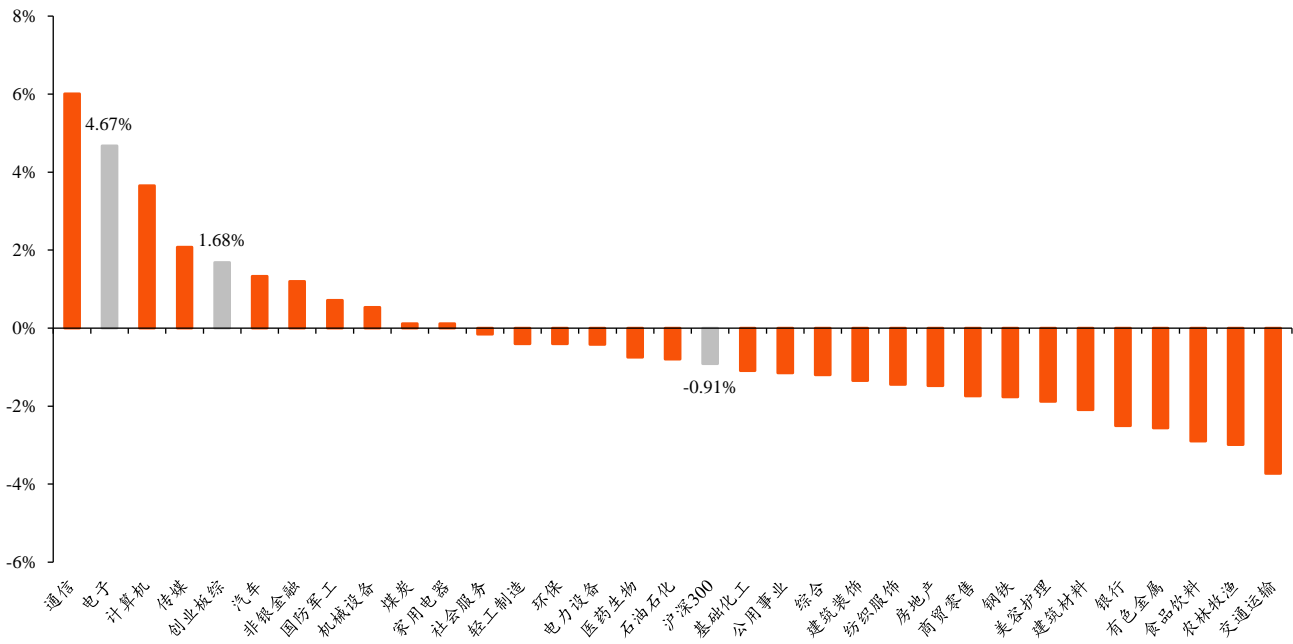
算力芯片：受益于算力需求持续攀升，有望带动上游算力芯片需求增长。建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等。

2. 市场回顾

2.1. 板块表现

本周（6.10-6.14），A股申万电子指数上涨4.67%，板块整体跑赢沪深300指数5.59pct，跑赢创业板综指数2.99pct。在申万31个一级子行业中，电子板块周涨跌幅排名为第2位。

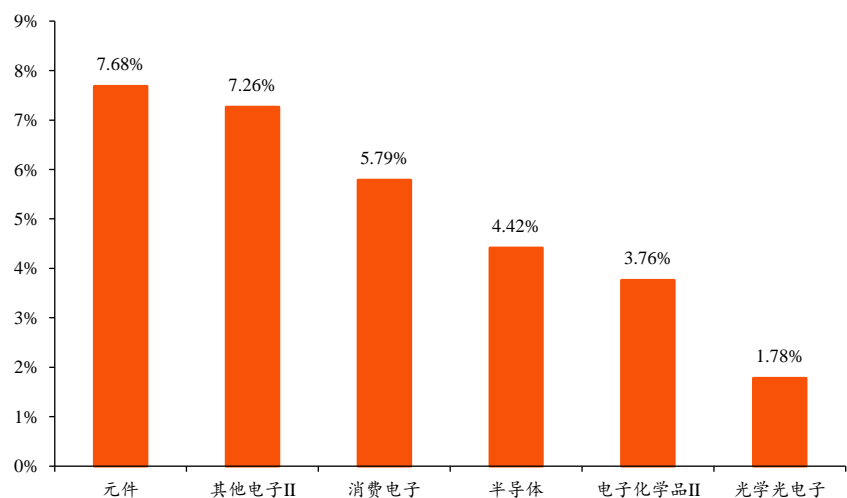
图1:A股申万一级行业涨跌幅情况（6.10-6.14）



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

本周（6.10-6.14）申万电子二级行业中，元件板块上涨7.68%，表现较好；光学光电子板块上涨1.78%，表现较差。电子二级行业涨跌幅由高到低分别为：元件(7.68%)、其他电子 II(7.26%)、消费电子(5.79%)、半导体(4.42%)、电子化学品 II(3.76%)、光学光电子(1.78%)。

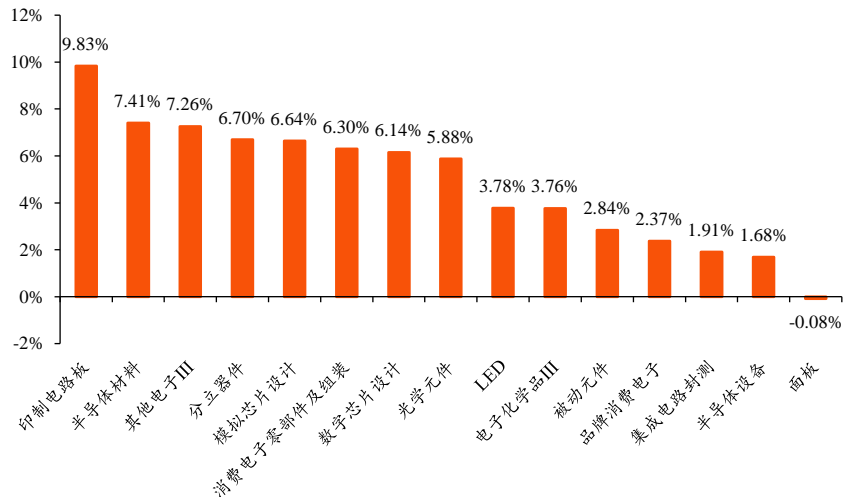
图2:A股申万二级行业涨跌幅情况（6.10-6.14）



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

本周（6.10-6.14）申万电子三级行业中，印制电路板板块上涨 9.83%，表现较好；面板板块下跌 0.08%，表现较差。表现靠前的板块分别为：印制电路板(9.83%)、半导体材料(7.41%)、其他电子III(7.26%)。表现靠后的板块分别为：面板(-0.08%)、半导体设备(1.68%)、集成电路封测(1.91%)。

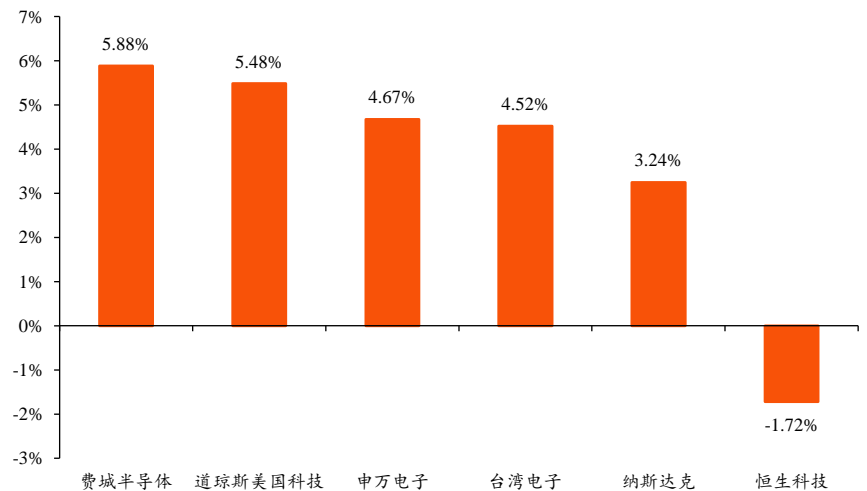
图3:A 股申万三级行业涨跌幅情况（6.10-6.14）



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

从海外市场指数表现来看，整体继续维持强势。本周（6.10-6.14），海内外指数涨跌幅由高到低分别为：费城半导体(5.88%)、道琼斯美国科技(5.48%)、申万电子(4.67%)、台湾电子(4.52%)、纳斯达克(3.24%)、恒生科技(-1.72%)。

图4:海内外指数涨跌幅情况（6.10-6.14）



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

2.1. 个股表现

本周(6.10-6.14)个股涨跌幅前十位分别为:安路科技(+44.46%)、逸豪新材(+39.51%)、东晶电子(+38.46%)、杰美特(+37.23%)、台基股份(+31.56%)、生益电子(+28.15%)、东田微(+25.69%)、英力股份(+23.7%)、飞凯材料(+23.63%)、雅创电子(+23.45%)。个股涨跌幅后十位分别为:超华科技(-17.91%)、中晶科技(-6.6%)、中芯集成(-5.54%)、骏成科技(-5.14%)、四会富仕(-4.8%)、通富微电(-4.37%)、维峰电子(-4.09%)、联动科技(-4.03%)、澳弘电子(-3.88%)、派瑞股份(-3.39%)。

表1:电子行业(申万)个股本周涨跌幅前后10名(6.10-6.14)

周涨跌幅前10名			周涨跌幅后10名		
证券代码	股票简称	周涨幅(%)	证券代码	股票简称	周跌幅(%)
688107.SH	安路科技	44.46%	002288.SZ	超华科技	-17.91%
301176.SZ	逸豪新材	39.51%	003026.SZ	中晶科技	-6.60%
002199.SZ	东晶电子	38.46%	688469.SH	中芯集成	-5.54%
300868.SZ	杰美特	37.23%	301106.SZ	骏成科技	-5.14%
300046.SZ	台基股份	31.56%	300852.SZ	四会富仕	-4.80%
688183.SH	生益电子	28.15%	002156.SZ	通富微电	-4.37%
301183.SZ	东田微	25.69%	301328.SZ	维峰电子	-4.09%
300956.SZ	英力股份	23.70%	301369.SZ	联动科技	-4.03%
300398.SZ	飞凯材料	23.63%	605058.SH	澳弘电子	-3.88%
301099.SZ	雅创电子	23.45%	300831.SZ	派瑞股份	-3.39%

资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

3. 行业新闻

高通确认骁龙 6s Gen 3 芯片为增强版 695：提升 CPU、GPU 和 AI 性能

6月15日消息，根据IT之家报道，高通公司证实，骁龙6s Gen 3芯片并非什么新产品，而是骁龙695（2021年发布）的增强版本，主要提升CPU、GPU和AI性能。高通公司于6月7日发布骁龙6s Gen 3处理器，其部件编号为SM6375-AC，和旧款骁龙695芯片（SM6375）几乎相同，并采用相同的6nm工艺。这两款芯片组共享相同的CPU设置、GPU、调制解调器、相机功能和无线连接套件。高通公司已证实，骁龙6s Gen 3是一款“增强型”骁龙695。

资料来源：(IT之家)

整合代工、存储和先进封装，三星电子推出一站式AI解决方案

6月13日消息，根据IT之家报道，三星电子发布三星AI解决方案。该方案整合了三星内部晶圆代工、存储和先进封装服务，是一个“交钥匙”的AI芯片制造平台。通过整合各业务部门的独特优势，三星可提供高性能、低功耗和高带宽的AI芯片解决方案，能根据客户特定需求定制芯片。三星电子内部的跨部门合作还简化了生产流程中的供应链管理（SCM），缩短了上市时间，使总周转时间显著提高了20%。目前三星电子可提供处理器与HBM内存间2.5D封装集成的整体解决方案。

资料来源：(IT之家)

电气硝子推出新型玻璃-陶瓷基板 GC Core

6月12日消息，根据IT之家报道，日本电气硝子近日宣布推出新型半导体基板材料GC Core。相较于有机基板，玻璃基板更为坚固，表面更为光滑，更便于承载超精细电路，是先进封装领域的明星技术。英特尔、三星等一系列重要半导体企业均已在这个方向发力。然而，玻璃材质本身的脆性又在一定程度上限制了玻璃基板的应用：玻璃基板的最大优势是其支持构建TGV（玻璃通孔）垂直通道，但目前使用常见的CO2激光器在玻璃基板上钻孔时容易出现裂纹，最终可能导致基板破裂。如果想避免这一问题，则要改用激光改性和蚀刻处理来打孔。这一方案不仅技术上更为麻烦，也将引入额外开支。电气硝子此次开发出的GC Core基板芯材由玻璃粉末和陶瓷粉末低温共烧而成，拥有陶瓷的部分性质，不易产生裂纹，可直接使用CO2激光器钻孔，降低量产成本。

资料来源：(IT之家)

GB200采用NVLink技术，展现铜缆连接在高性能计算领域的潜力

3月29日消息，根据财联社报道，黄仁勋介绍，GB200采用72个Blackwell GPU全互连的NVLink技术，拥有超过2英里的NVLink铜缆，

展现了铜缆连接在高性能计算领域的巨大潜力。英伟达此举是为了减少其数据中心设备的耗电量，使用铜而不是光学器件，可以为每个服务器机架节省 20 千瓦的电力。

资料来源：(财联社)

4. 公司动态

【汇成股份】公司 DDIC 下游具体应用领域近期较为景气

6月12日消息，汇成股份在投资者互动平台表示，2024年上半年受益于年内体育赛事等因素影响，下游高清电视等大尺寸显示驱动芯片终端需求旺盛；小尺寸显示驱动芯片中部分新型应用场景的品类在近期呈现快速增长态势，如电子标签、电子烟、智能穿戴、智能家居等。

资料来源：（投资者互动平台）

【宏微科技】公司碳化硅产品进度良好

6月12日消息，宏微科技在投资者互动平台表示，公司提前布局 SiC 芯片和封装业务，相关的 SiC 模块已批量应用于新能源行业，在第三代功率半导体器件领域的研发和量产具有先发优势；自主研发的 SiCSBD（肖特基势垒二极管）芯片已经通过可靠性验证，并已向重点客户送样，正在测试阶段。

资料来源：（投资者互动平台）

【裕太微】公司持续攻坚以太网相关技术

6月14日消息，裕太微在投资者互动平台表示，目前市场正处在 IB 向以太网转换的重要节点，过去市场认为 IB 网络因其 0 丢包率等优势将横扫 AI 市场，但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本，以太网逐渐成为拓展性 AI 训练工作负载的首选网络。公司的以太网全系列芯片均属于高速有线通信芯片的范畴，目前使用的均为铜缆介质。在标准以太网下铜缆介质的最高传输速率为 10G。公司目前已量产的以太网系列芯片最高速率为 2.5G，公司在研的以太网系列芯片最高速率为 10G。公司在研的高速以太网芯片可用于数据中心等领域中，适用于部分 AI 设备。待突破 10G 传输速率并进入到自定义模式后，公司将持续攻坚铜缆超高速连接芯片，以期实现以以太网物理层芯片为切入口的高速有线通信芯片的全球化路径。

资料来源：（投资者互动平台）

5. 公司公告

表2:电子行业本周重点公告 (6.10-6.14)

日期	公司	公告类型	要闻
2024/06/10	硕中科技	利润分配	本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,189,037,288 股为基数, 每股派发现金红利 0.1 元 (含税), 共计派发现金红利 118,903,728.80 元。
2024/06/11	华润微	利润分配	本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本 1,323,517,004 股为基数, 每股派发现金红利 0.1118 元 (含税), 共计派发现金红利 147,969,201.05 元。
2024/06/11	华天科技	利润分配	以公司现有总股本 3,204,484,648 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.220000 元人民币现金 (含税; 扣税后, 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.198000 元)。
2024/06/12	世运电路	利润分配	本次利润分配以方案实施前的公司总股本 658,537,345 股为基数, 每股派发现金红利 0.5 元 (含税), 共计派发现金红利 329,268,672.5 元。
2024/06/13	上海贝岭	利润分配	本次利润分配以方案实施前的公司总股本 708,923,303 股为基数, 每股派发现金红利 0.10 元 (含税), 共计派发现金红利 70,892,330.30 元。

资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

6. 风险提示

1) 中美贸易摩擦加剧的风险

未来若中美摩擦加剧，则存在部分公司的经营受到较大影响的风险。

2) 下游终端需求不及预期的风险

未来若下游终端需求不及预期，则存在产业链相关公司业绩发生较大波动的风险。

3) 国产替代不及预期的风险

未来若国产替代不及预期，则存在国内企业的业绩面临承压的风险。

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，专业审慎的研究方法，独立、客观地出具本报告，保证报告采用的信息均来自合规渠道，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本报告所发表的任何观点均清晰、准确、如实地反映了研究人员的观点和结论，并不受任何第三方的授意或影响。此外，所有研究人员薪酬的任何部分不曾、不与、也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

甬兴证券有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可，具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数

相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准指数。

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

特别声明

在法律许可的情况下，甬兴证券有限公司(以下简称“本公司”)或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问以及金融产品等各种服务。因此，投资者应当考虑到本公司或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。也不应当认为本报告可以取代自己的判断。

版权声明

本报告版权属于本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用本报告中的任何内容。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。

重要声明

本报告由本公司发布，仅供本公司的客户使用，且对于接收人而言具有保密义务。本公司并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为本公司的客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐及其他交流方式等只是研究观点的简要沟通，需以本公司发布的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，本公司对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时思量各自的投资目的、财务状况以及特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。市场有风险，投资须谨慎。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司和关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。投资者应当自行关注相应的更新或修改。